

GIST 반도체공학과 참여 컨소시엄, 과기정통부 '반도체 첨단 패키징 전문인력 양성사업' 선정

- GIST 반도체공학과 소속 교원 6명 주축으로 반도체 첨단 패키징 전 분야 포괄하는 교육체계 구축, 혁신 주도할 석·박사급 전문인력 양성... 7년간 총사업비 105억 원 지원
- GIST에 건립 중인 'AI 반도체 첨단 후공정 특화 팹'과 연계해 기업 실무형 인재 길러... "광주광역시도 반도체 첨단 패키징 산업의 중심지로 자리잡을 수 있도록 최선 다할 것"



▲ (앞줄 왼쪽부터 시계 반대방향으로) GIST 반도체공학과 이동선 학과장, 과제책임자 신현진 교수, 과제실무자 윤훈한 교수, 정현호 교수, 이일민 교수, 강동호 교수

광주과학기술원(GIST, 총장 임기철)은 과학기술정보통신부가 추진하는 '2024년도 과학기술혁신인재양성사업(반도체 첨단패키징 전문인력 양성사업)'에 선정됐다고 12일 밝혔다.

과학기술정보통신부는 최근 반도체 기술 경쟁의 새 화두로 떠오른 '첨단 패키징' 분야의 전문인력 양성을 위한 '반도체 첨단 패키징 전문인력 양성사업' 선정 결과를 지난 7월 31일 발표했으며, 조선대가 주관하고 GIST를 비롯한 전남대, 인하대 및 18개의 첨단 패키징 중견·중소기업이 참여하는 컨소시엄이 선정되어 2024년 7월부터 7년간, 총 사업비 105억 원을 지원받을 예정이다.

GIST는 반도체공학과 소속 교원 6명이 주축이 되어(참여 교수: 이동선 학과장, 신현진·윤훈한·강동호·이일민·정현호 교수), ▲소재·부품·장비 ▲공정·시스템 ▲설계·시뮬레이션 ▲신뢰성 테스트·분석 등 반도체 첨단 패키징 전 분야를 아우르는 교육체계를 구축하고 전공기초, 전공심화, 융합전공 등 트랙별 실무 교과목을 개발할 예정이다.

나아가 계약정원제를 통해 산업현장의 요구를 반영한 기업 맞춤형 전문인력 육성 및 산학협력 연구 프로젝트를 수행할 계획이다.

특히, GIST는 '칩렛 이중 집적' 및 '팬아웃 패키징' 등 차세대 인공지능(AI) 반도체 개발을 위해 390.5억 원(국비 266.5억 원 및 지방비 124억 원)을 들여 구축하고 있는 5,520㎡ (팹 전용 3,312㎡) 규모의 AI 반도체 첨단 후공정 특화 팹을 '반도체 첨단 패키징 전문인력 양성사업'과 연계할 방침이다.

이를 통해 기업이 필요로 하는 실무형 인재를 양성할 수 있는 최상의 교육·연구 환경을 제공함으로써 첨단산업의 글로벌 경쟁력 확보를 위한 반도체 첨단 패키징 특화형 석·박사 인재 양성 체계를 구축한다는 전략이다.

연구책임자를 맡은 신현진 교수는 "이번 사업 선정으로 GIST 대학원생들에게 반도체 첨단 패키징 기술 습득과 실무 경험 기회가 크게 확대될 것으로 기대한다"며 "참여 기업들과의 협력을 통해 광주광역시가 반도체 첨단 패키징 산업의 중심지로 자리 잡을 수 있도록 교두보 역할에 최선을 다할 것"이라고 말했다.

한편, '반도체 첨단 패키징 전문인력 양성사업'은 반도체 후공정 고도화에 발맞춰 패키징 설계, 파운드리, 조립 및 검사(OSA) 경쟁력을 강화하고자 ▲소부장(소재·부품·장비) ▲공정·시스템 ▲설계·시뮬레이션 ▲신뢰성 테스트·분석 등 첨단 패키징 분야별 석·박사급 고급 인력을 길러내기 위한 과기정통부의 전문인력 양성사업이다.

올해부터 2031년까지 예산 총 240억 원을 투입해 경쟁력을 갖춘 대학·기업·연구소 등으로 구성된 컨소시엄을 선정, '첨단 패키징 전문인력 양성센터'를 올해와 내년에 각각 1곳씩 설립할 계획이다.



▲ GIST 반도체공학과에 구축 중인 390.5억 원 및 5,520㎡ 규모의 인공지능 반도체 첨단 후공정 특화 팹 조감도. (2026년 완공 예정)

올해는 조선대가 주관하고 GIST를 비롯한 전남대, 인하대 및 18개의 첨단 패키징 중견·중소기업이 참여하는 컨소시엄이 선정되었으며, 조선대에 '첨단 패키징 전문인력 양성센터'를 설립하여 2027년까지 30명 이상, 2028~2030년 중 60명 이상의 석·박사 졸업생을 배출하는 것이 목표이다.